

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于成都宏明电子股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**之**  
**上市保荐书**

保荐人（主承销商）



**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD**

二〇二五年十二月

目 录

目 录.....1

一、发行人概况.....2

二、发行人本次发行情况.....26

三、本次证券发行项目组情况.....27

四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说明  
.....29

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项.....30

六、保荐人按照有关规定应当说明的事项.....30

七、保荐人对发行人持续督导工作的安排.....35

八、其他说明事项.....36

九、保荐人结论.....36

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”、“本保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

## 一、发行人概况

### （一）发行人基本情况

中文名称	成都宏明电子股份有限公司
英文名称	Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd.
注册资本	9,116.2018 万元
法定代表人	梁涛
实业总公司成立日期	1981 年 10 月 8 日
股份公司成立日期	2000 年 9 月 15 日
住所	四川省成都市成华区建设路 43 号 17 栋 2 层 8 号
主要经营场所	四川省成都市龙泉驿区北京路 188 号
邮政编码	610199
电话	028-84391463
传真	028-84337617
互联网网址	<a href="http://www.chinahongming.com">http://www.chinahongming.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:zqswb@chinahongming.com">zqswb@chinahongming.com</a>
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
负责信息披露和投资者关系的负责人	梁爽
负责信息披露和投资者关系的联系方式	028-84391463

### （二）发行人的主营业务

发行人主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售，

致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品。同时，公司还涉及精密零组件业务，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域和新能源电池及汽车电子结构件等领域。

## 1、电子元器件

作为国内老牌电子元器件制造商，发行人拥有 60 多年的电子元器件研制经验和技術沉淀，产品体系全面，产品层次丰富，目前已掌握多项具有自主知识产权的核心技术，主要产品包括多层瓷介电容器（MLCC）、芯片瓷介电容器、有机及云母电容器、钽电解电容器、热敏电阻器、位移传感器等阻容元器件产品，以及滤波/连接器、微波器件等其他电子元器件产品。在防务领域，发行人 MLCC、有机及云母电容器、位移传感器、热敏电阻器等高可靠产品具有较强竞争优势，多次承担国家重点装备和重点工程的电子元器件科研攻关和生产配套任务，为航空航天、武器装备、船舶、核工业等领域国家重点工程项目配套，多次获得各重点项目承制单位的表彰及感谢信；在民用领域，发行人电子元器件产品主要应用于消费电子、汽车电子等领域。

发行人是国内少数从高品质电子材料（陶瓷瓷料和导电浆料）到电子元器件均具备研制能力的全产业链生产企业，并实现了多个产品的国产化替代，曾创造了国内第一条有机薄膜介质电容器国军标生产线、第一条宇航级 MLCC 生产线、第一条正温度系数热敏电阻器国军标生产线、第一条负温度系数热敏电阻器国军标生产线、第一条抗电磁干扰滤波器国军标生产线等多项国内第一。

## 2、精密零组件

在精密零组件领域，发行人以产品设计、精密模具研发、智能制造为核心竞争力，紧跟电子信息产业快速发展的步伐，不断开发、设计高精密、高附加值新产品，拓展并完善公司的业务及产品体系。多年来，发行人为苹果、联想、摩托罗拉等知名品牌商的平板电脑、笔记本电脑、手机等消费电子产品提供配套，并成为苹果公司产业链上的重要供应商之一。此外，近年来，发行人积极拓展新能源汽车领域业务机会，开发新能源电池及汽车电子结构件产品。目前，公司已通过行业主流客户的认证，技术参数达到客户高标准要求，开始为客户小批量供货。

近年来，发行人获得多项国家级、省级和行业级重要荣誉。2024 年，宏科电子被四川省科学技术厅评为“四川省宇航元器件电子功能材料工程技术研究中心”，宏明日望被湖南省工业和信息化厅评为“湖南省省级企业技术中心”；2023 年，发行人被四川省人民政府授予四川省科学技术进步奖三等奖，被四川省科学技术厅评为“四川省被动元器件研制工程技术研究中心”，被中国电子元件行业协会授予科技进步二等奖，宏明双新被中国模具工业协会授予“精模奖一等奖”等；2022 年，发行人被四川省经济和信息化厅评为四川省制造业“贡嘎培优”企业，宏明双新被四川省科学技术厅评为“四川省 3C 精密零组件工程技术研究中心”、被四川省发展和改革委员会评为“四川省中小型精密结构件及模具制备技术工程研究中心”，宏科电子被四川省发展和改革委员会评为“四川省宇航电子高可靠瓷介电容工程研究中心”等；2021 年，发行人特种多层陶瓷电容器产品被工信部、中国工业经济联合会评为“制造业单项冠军产品”，宏科电子被四川省人民政府授予四川省科学技术进步奖三等奖，发行人被四川省发展和改革委员会评为“四川省高可靠阻容元器件制造技术工程研究中心”等。

截至报告期末，发行人拥有 1 个国家“863”电子瓷料研发中心、1 个国家企业技术中心、1 个国家认证检测校准实验中心、1 个国家认证检测实验中心、6 个省级工程（技术）研究中心、3 个省级企业技术中心、2 个院士（专家）工作站、1 个技能大师工作室。发行人连续多年被评为国家高新技术企业。2020 年，发行人入选国务院“科改示范企业”名单，实施科改行动以来，发行人于 2020 年被国务院改革办评为科改“标杆”，2021 年获评“优秀”，2022 年和 2023 年分别再次获评“标杆”。2024 年，被工信部评为专精特新小巨人企业。从 1987 年至今，发行人已连续 30 多年荣获“中国电子元件百强企业”称号。

### （三）发行人的核心技术和研发水平

#### 1、核心技术

经过多年持续投入和经验积累，发行人已经在生产与工艺领域形成了多项核心技术。截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有境内专利共 1,275 项，其中发明专利 239 项，实用新型专利 1,031 项，外观设计专利 5 项。公司拥有的核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	涉及的主要产品	技术先进性及具体表征	知识产权保护情况	技术所处阶段	技术来源
1	电子瓷料配方设计及其制备技术	陶瓷电容器瓷料以及所生产的电容器产品	采用掺杂改性技术,解决了不同瓷料产品微观晶相中的“壳-芯”结构构建及稳定性控制、居里峰移动和展宽、瓷料颗粒形貌控制等技术难点。制备时提升了瓷料粒径分布,增强了瓷料的抗电强度,降低了瓷料的损耗角正切值,提升了瓷料的 VCC 等性能指标。	已获得发明专利 9 项	大批量生产阶段	自主研发
2	电极浆料配方设计及其制备技术	陶瓷电容器浆料以及所生产的电容器产品	该技术选用特定的无机材料、有机材料和金属材料,控制其物理特性,按不同的比例、特定的程序调配,研制各电极浆料配方。同时通过浆料预分散、研磨后过滤等技术手段,制备出均匀性和分散性优良的浆料。	已获得发明专利 5 项	大批量生产阶段	自主研发
3	小型化高可靠电容器产品制造技术	陶瓷电容器	该技术通过对介质薄层化制备、高精度电极印刷、高精度叠层、快速烧结、精密切割等关键技术攻关,提升了粉体粒度的分散度、一致性以及膜片叠层精度,实现在超薄介质膜片上精密堆叠多层的工艺实践,制备出小体积大容量的高可靠陶瓷电容器。	已获得发明专利 5 项,实用新型专利 27 项	大批量生产阶段	自主研发
4	卷绕技术	有机及云母电容器	该技术通过对张力、错位量和转速等参数的控制,将一定厚度和层数的介质薄膜和内电极叠加、卷绕,形成具有一定电容量和耐电压能力的电容器芯子。目前,该技术在芯子薄膜无折痕、介质层间应力分布均匀的情况下实现超薄薄膜的卷绕,大幅提升有机薄膜电容器单位体积的电容量和工作可靠性。	已获得发明专利 3 项,实用新型专利 3 项	大批量生产阶段	自主研发
5	灌封技术	有机及云母电容器	根据灌注材料的性能和工艺特性,采用适当的灌封工艺(包括对材料粘度、流向、流速和流量的调控等),实现对有机薄膜电容器芯组的包封,使有机薄膜电容器具有较强的适应能力。	已获得发明专利 7 项,实用新型专利 12 项	大批量生产阶段	自主研发
6	高能钽混合电容器制备技术	钽电解电容器	该技术通过成型、烧结、赋能等工艺制备钽阳极芯块和复合材料阴极片,满足防务领域对高电压、大容量、小体积的气密封电容器的使用需求,实现了该类电容器的国产化替代。	已获得发明专利 5 项,实用新型专利 12 项	大批量生产阶段	自主研发
7	热敏电阻瓷料研发技术	热敏电阻器	该技术通过对热敏电阻器用半导体陶瓷配方的研究,快速设计不同电参数产品所需瓷料配方以满足航空、航天等领域更宽泛的技术指标要求,大幅提升设计效率。	已获得发明专利 3 项,实用新型专利 11 项	大批量生产阶段	自主研发
8	小型化热敏电阻器制造技术	热敏电阻器	该技术立足于小型化及微型化热敏元件的研发制造,形成针对不同结构小型化敏感元件产品的快速设计、制备及测试的先进方法,大幅提升小型化热敏电阻器的研究制备效率及可靠性。	已获得发明专利 1 项,实用新型专利 7 项	大批量生产阶段	自主研发

序号	核心技术名称	涉及的主要产品	技术先进性及具体表征	知识产权保护情况	技术所处阶段	技术来源
9	导电塑料电位器及传感器制备技术	位移传感器	该技术通过设计电阻浆料、粘结剂、导电相等材料的配比,经过印刷、固化形成电阻体。该技术决定了浆料的细度、粘度以及聚合物的电阻一致性,直接影响位移传感器的寿命和精度。	已获得发明专利 6 项,实用新型专利 21 项	大批量生产阶段	自主研发
10	磁路设计技术	位移传感器	该技术利用磁场强度驱动敏感组件,保证传感器在运动状态下内部磁场的稳定性,提升磁敏传感器精度的同时降低回程误差。	已获得发明专利 9 项,实用新型专利 23 项	大批量生产阶段	自主研发
11	滤波元件制备技术	滤波/连接器	该技术通过芯片设计、板式电容打孔成型、焙烧技术等关键制备技术实现滤波器核心零部件自主可控。	已获得发明专利 1 项	小批量生产	自主研发
12	射频干扰滤波器结构设计及装配技术	滤波/连接器	该技术通过超小型芯片成型、玻璃绝缘子局部电镀以及贴片红胶阻断等关键技术,实现小型化射频干扰滤波器结构设计及装配。	已获得发明专利 2 项,实用新型专利 10 项	技术研究	自主研发
13	模具设计制造技术	3C 精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件	通过多种模具设计技术(包括锻压成型技术、密集微小孔冲压技术、模内组装技术、模内焊接技术、模内铆接技术等)的运用,采用模具制造全工序(电加工、切削加工、热处理、磨削等工序)高精密模具加工配套设备,实现产品多模块、多功能的工艺成型以及高精度模具的高效制造,并通过模具与自动化连线一体化设计,实现精密零组件产品智能化生产,保证产品质量稳定性和生产效率。	已获得发明专利 29 项,实用新型专利 54 项	大批量生产阶段	自主研发
14	产品成型技术	3C 精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件	该技术利用精密冲压模具、精密注塑及嵌塑模具、冲压设备和注塑设备,将 CNC 加工与自动化技术相结合,开发机械手和自动控制系统、物料系统,实现金属带料的一次冲压成型和产品的连续大批量自动化生产,实现卷对卷 CNC 连续生产和注塑/嵌塑产品的无人化生产,产品冲压精度达到 $\pm 0.05\text{mm}$ ,冲压速度最高可达 1000pcs/min、注塑精度达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ,实现机内尺寸在线检测(精度达到 $\pm 0.02\text{mm}$ )、自动装夹连续生产、自动清理废屑、断刀状况在线监测的智能生产模式。	已获得发明专利 9 项,实用新型专利 28 项	大批量生产阶段	自主研发
15	自动化技术	3C 精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件	通过对自动化设备的研究和开发,提高包装设备的生产效率(编带包装机效率最高可达 9K/H,托盘包装机效率最高可达 4.5K/H,弹片包装机效率可以达到 10K/H);提高裁切设备的裁切精度和裁切效率(裁切口毛刺可控制在 0.03mm 内,裁切精度达到 $\pm 0.02\text{mm}$ ,	已获得发明专利 19 项,实用新型专利 73 项	大批量生产阶段	自主研发

序号	核心技术名称	涉及的主要产品	技术先进性及具体表征	知识产权保护情况	技术所处阶段	技术来源
			效率达到 3pcs/s)；对于视觉检测设备，能够实现多产品的尺寸测量和多种物体的三维测量；对于贴膜设备，可以实现单机多膜贴合或多机串联作业，提升单膜贴合速度和贴膜精度，单膜贴合速度可达到 0.8s/pcs，贴膜精度可达±0.1mm。此外，冲压、清洗等全连线生产线可实现无人化生产，生产效率显著提高。			

## 2、研发水平

### (1) 发行人取得的重要奖项

公司自设立以来，一直专注于电子元器件的研发、生产、销售，并于 2000 年成立宏明双新，开展精密零组件业务。经过多年积累，公司储备了一批业内顶尖的研发人才，形成了较为完善的研发体系和较强的科研实力。近年来，公司获得的主要荣誉如下：

序号	荣誉名称	获得时间	颁发机构	获奖主体
一、国家级证书				
1	专精特新小巨人企业	2024 年	工业和信息化部	宏明电子
2	制造业单项冠军产品	2021 年	工业和信息化部、中国工业经济联合会	宏科电子
3	国家技术创新示范企业	2018 年	工业和信息化部	宏明电子
4	国家企业技术中心	2017 年	国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局	宏明电子
二、省级证书				
5	四川省重大技术装备国内首台套产品（高精度磁敏角位移传感器）	2024 年	四川省经济和信息化厅、四川省财政厅	宏明电子
6	四川省重大技术装备省内首台套产品（飞机副主动动力系统电磁兼容部组件产品）	2024 年	四川省经济和信息化厅、四川省财政厅	宏明电子
7	湖南省省级企业技术中心	2024 年	湖南省工业和信息化厅	宏明日望
8	湖南省创新创业大赛优秀奖	2024 年	湖南省科学技术厅	宏明日望
9	四川省宇航元器件电子功能材料工程技术研究中心	2024 年	四川省科学技术厅	宏科电子
10	高新技术企业证书	2024 年	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	宏明华瓷
11	四川省科学技术进步奖三等奖	2023 年	四川省人民政府	宏明电子



序号	荣誉名称	获得时间	颁发机构	获奖主体
12	四川省国资国企改革工作先进集体	2023 年	四川省人力资源和社会保障厅、四川省政府国有资产监督管理委员会	宏明电子
13	四川省被动元器件研制工程技术研究中心	2023 年	四川省科学技术厅	宏明电子
14	高新技术企业证书	2023 年	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	宏明电子
15	高新技术企业证书	2023 年	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	宏科电子
16	高新技术企业证书	2023 年	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	宏明双新
17	高新技术企业证书	2023 年	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局	宏明日望
18	四川省制造业“贡嘎培优”企业	2022 年	四川省经济和信息化厅	宏明电子
19	四川省 3C 精密零组件工程技术研究中心	2022 年	四川省科学技术厅	宏明双新
20	四川省中小型精密结构件及模具制备技术工程研究中心	2022 年	四川省发展和改革委员会	宏明双新
21	四川省宇航电子高可靠瓷介电容工程研究中心	2022 年	四川省发展和改革委员会	宏科电子
22	四川省科学技术进步奖三等奖	2021 年	四川省人民政府	宏科电子
23	四川省高可靠阻容元器件制造技术工程研究中心	2021 年	四川省发展和改革委员会	宏明电子
<b>三、行业级证书</b>				
24	中国电子元器件骨干企业 TOP100	2024 年	中国电子元件行业协会	宏明电子
25	四川企业技术创新能力百强企业第 6 位	2024 年	四川省企业联合会、四川省企业家协会、四川省企业发展促进中心	宏明电子
26	四川企业技术创新能力百强企业	2024 年	四川省企业联合会、四川省企业家协会、四川省企业发展促进中心	宏明双新
27	2024 年四川制造业 100 强	2024 年	四川省企业联合会、四川省企业家协会	宏明电子
28	2024 年四川数字经济 100 强	2024 年	四川省企业联合会、四川省企业家协会	宏明电子
29	2024 年四川数字经济 100 强	2024 年	四川省企业联合会、四川省企业家协会	宏明双新
30	中国电子元件行业协会科学技术奖科技进步奖二等奖	2023 年	中国电子元件行业协会	宏明电子
31	精模奖一等奖	2023 年	中国模具工业协会	宏明双新
32	2022 年四川企业技术创新发展能力 100 强企业连续六年入榜	2022 年	四川省企业联合会、四川省企业家协会、四川经济日报社	宏明电子

序号	荣誉名称	获得时间	颁发机构	获奖主体
	企业			
33	中国电子元件行业协会科学技术奖科技进步奖二等奖	2021 年	中国电子元件行业协会	宏明电子

(2) 发行人承担的科研项目情况

公司是国家“一五”时期 156 项重点建设工程之一，具有 60 多年的电子元器件研制经验和技術沉淀，长期为航空航天、武器装备、船舶、核工业等国家重点工程项目配套。2020 年至今，发行人承担国家重点工程项目 25 项。

(3) 学术期刊论文发表情况

报告期内，发行人核心技术人员及其他员工在业内期刊发表多篇论文，具体如下：

序号	论文题目	论文作者	刊物名称	发表时间
1	砂磨工艺对镍电极多层瓷介电容器性能及可靠性的影响	易凤举、何云飞等	《电子元件与材料》	2025.07
2	Orthogonal orientation incorporated gradient-sandwich structure for enhanced energy storage performance of all-inorganic nanocomposites	沈秉忠、谢波等	《Composites Part B: Engineering》	2025.06
3	MLCC 失效机理分析与可靠性提升方法研究	王静、孙慧楠等	《日用电器》	2025.04
4	螺线管电极加工方法优化与实际应用案例	黄敏、曾杰等	《模具工业》	2025.03
5	6061/4047 铝合金激光封焊显微组织及性能研究	徐强、杨丽菲等	《电子与封装》	2025.02
6	Exploring the fracture mechanism of multilayer ceramic capacitors via combined simulation and experiment	徐琴等	《Microelectronics Reliability》	2025.02
7	叠层片式热敏电阻表面绝缘处理技术的研究进展	程飞鹏、文昕等	《电子元件与材料》	2025.01
8	镍电极 MLCC 排胶后残碳量及其电性能研究	易凤举、陈沫言等	《电子与封装》	2025.01
9	The influence of varying density of dielectric layer on BME-MLCC	杨启航、程淇俊等	《Journal of Materials Science: Materials in Electronics.》	2024.12
10	卸料板镶件失效分析与模具结构优化	严一钊、林静财等	《模具工业》	2024.12
11	具有圆弧曲面特征的模具镶件组合制造工艺	林静财、严一钊等	《模具工业》	2024.09
12	一种旋翼无人机用高密度电连接器的设计	余睿、吴旭娇等	《机电元件》	2024.08

序号	论文题目	论文作者	刊物名称	发表时间
13	MLCC 手工焊接质量控制研究	杜琳琳、金洪斌等	《电子质量》	2024.07
14	氧化铝陶瓷封装外壳电镀爬金缺陷分析与解决	刘朋、张浩宇等	《电镀与精饰》	2024.07
15	Effects of LiMoVO6 on phase composition and microwave dielectric properties of ultra-low firing Al2Mo3O12 ceramics	熊喆、高大伟等	《Journal of Materials Science: Materials in Electronics》	2024.06
16	Bond theory,vibrational spectroscopy,and dielectric responses of trirutile ATa2O6 (A=Mg,Ni)microwave ceramics	熊喆、郭泽旭等	《Ceramics International》	2024.06
17	微型点阵凸模磨削加工工艺研究	林静财、杨金健等	《模具工业》	2024.06
18	(Zr, Ti) O4 基微波薄膜介质基片制备关键工艺研究	江俊俊、康建宏等	《材料导报》	2024.05
19	Nd2O3 对 (Zr0.8,Sn0.2) TiO4 微波介质陶瓷结构和性能的影响	江俊俊、赵杨军等	《中国陶瓷》	2024.04
20	超级电容器用电极材料研究进展	肖富强、林广等	《当代化工研究》	2024.04
21	Phenomenological analysis of positive and negative electrocaloric effects in Rochelle salt	熊喆、李俊杰等	《 Applied Physics Letters》	2024.04
22	发动机连接器接触片级进模设计	游健、朱浔等	《模具工业》	2024.02
23	接插件端子卷对卷连续选择性点镀金工艺	刘振、张迪生等	《电镀与涂饰》	2023.08
24	Nb2O5 对 BaTiO3-0.83Y2O3 基陶瓷介电性能的影响	罗婷、汪小玲等	《中国陶瓷》	2023.08
25	氧化铝陶瓷封装外壳化学镀镍工艺优化	刘朋、李慧超等	《电镀与精饰》	2023.08
26	直流支撑电容器工作温升特性研究及优化设计	邱昊、高秀华等	《电子元件与材料》	2023.08
27	High dielectric constant perovskite ceramic sintered at low temperature with La-Li-Zn-B glass for LTCC applications	高秀华、熊喆等	《Journal of Materials Science: Materials in Electronics》	2023.07
28	片弹簧双带料模具内装配与焊接的级进模设计	游健、庄严等	《模具工业》	2023.06
29	Study of BaO-Nd2O3-TiO2 ceramics doped with Li2O-ZnO-B2O3 glass for LTCC technology	熊喆、韩瑜轩等	《Journal of Materials Science: Materials in Electronics》	2023.04
30	空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定高纯碳酸锶中的氧化钡	梁英、周彬等	《化工管理》	2023.04
31	镀金片弹簧级进模设计	王希亮、庄严等	《模具工业》	2023.03

序号	论文题目	论文作者	刊物名称	发表时间
32	阴极电化学浸蚀去除 430 不锈钢板材表面硅氧层的研究	刘振、张迪生等	《电镀与涂饰》	2023.03
33	旋转圆盘电极方法研究电镀锡中的锡电化学还原反应	赵强、陈思源等	《四川化工》	2023.02
34	脉冲用金属化膜电容器稳态热分析研究	邱昊、高秀华等	《电子元件与材料》	2023.01
35	高压瓷介电容器脉冲开裂失效问题及材料选择	罗捷宇、高秀华等	《电子元件与材料》	2022.12
36	高精度卸料板镶件组合加工工艺	林静财	《模具工业》	2022.12
37	MLCC 瓷体表面水印产生原因分析及解决方案	赵强、陈思源等	《杭州化工》	2022.09
38	密集小孔精密冲压技术研究	王希亮、庄严等	《模具工业》	2022.07
39	冲裁凸模制造工艺的改进	林静财、刘健等	《模具制造》	2022.06
40	基于 UG 具有阵列特征夹具的数控加工	林静财、刘健等	《模具制造》	2022.05
41	弹簧片精密级进模设计	王希亮、庄严等	《模具工业》	2022.05
42	辅助夹具制造工艺的实践与研究	王华、林静财等	《模具制造》	2022.01

#### (4) 行业标准制定情况

作为国内老牌电子元器件生产企业，发行人主导和参与 61 项国家（军用）标准、行业标准制修订。2020 年至今，发行人主导或参与制定的主要标准情况如下：

序号	标准号	标准名称	标准类别	主导/参与	发布时间
1	GJB10171-2021	电源滤波器通用规范	国军标	参与	2021/12/30
2	GJB/Z37.3A-2021	军用电阻器和电位器系列型谱第 3 部分：电位器	国军标	参与	2021/12/30
3	GJB/Z38.1A-2021	军用电容器系列型谱第 1 部分：有机介质固定电容器	国军标	参与	2021/12/30
4	GJB/Z51.1A-2021	军用滤波器和网络系列型谱第 1 部分：电磁 / 射频干扰滤波器	国军标	参与	2021/12/30
5	GJB2442A-2021	有失效率等级的单层片式瓷介电容器通用规范	国军标	参与	2021/12/30
6	SJ/T10567-2020	电子元器件详细规范 CC2 型瓷介固定电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9
7	SJ/T10568-2020	电子元器件详细规范 CT2 型瓷介固定电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9
8	SJ/T10785-2020	电子元器件详细规范 CL10 型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9

序号	标准号	标准名称	标准类别	主导/参与	发布时间
9	SJ/T10786-2020	电子元器件详细规范 CL11 型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9
10	SJ/T10787-2020	电子元器件详细规范 CL12 型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9
11	SJ/T10874-2020	电子元器件详细规范 CL21 型金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9
12	SJ/T10875-2020	电子元器件详细规范 CC52 型圆片穿心瓷介电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9
13	SJ/T10876-2020	电子元器件详细规范 CT52 型圆片穿心瓷介电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9
14	SJ/T10998-2020	电子元器件详细规范 CBB13 型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器评定水平 EZ	行标	主导	2020/12/9

**(5) 科技成果鉴定情况**

报告期初至今，发行人多项技术成果通过了科技成果鉴定，分别达到了国际先进、国内领先等水平，具体情况如下：

序号	技术名称	鉴定单位	发布时间	鉴定结果
1	多台阶产品一次性拉深成型模具的设计及应用	成都晖光萤火科技有限公司	2025.01.21	国际先进
2	新能源电池圆形盖帽内扣成型工艺	成都晖光萤火科技有限公司	2025.01.21	国内先进
3	位移传感器技术成果 1	四川省科工办	2024.12.17	国际先进
4	位移传感器技术成果 2	四川省科工办	2024.12.17	国际先进
5	热敏电阻器技术成果 1	四川省科工办	2024.12.17	国际先进
6	电容器技术成果 1	四川省科工办	2024.12.17	国际先进
7	电磁微波系统用脉冲电容器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国内领先
8	脉冲功率电源系统用高储能密度脉冲电容器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国际先进
9	宇航用小体积大电流金属膜谐振电容器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国内领先
10	适应宇航环境的高可靠高压云母纸电容器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国际先进
11	航天用带滤波功能的连接器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国内领先
12	具有滤波功能的柔性电连接器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国内领先

序号	技术名称	鉴定单位	发布时间	鉴定结果
13	接触件可浮动高可靠大电流滤波电连接器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国际先进
14	高精度、耐高温测温用铂电阻温度传感器技术及应用	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国内领先
15	航空电动机构用内嵌式高抗振高可靠滤波器结构	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国内领先
16	反辐射弹舵机系统用滤波组件	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国际先进
17	航空航天发动机点火系统一体化滤波组件	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国际先进
18	小间距高密度低高度印制板电连接器技术及应用	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国内领先
19	伺服机构用高可靠小型化拉杆式直线位移传感器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国际先进
20	伺服系统用耐高温高精度直线位移传感器	成都中物鉴智科技有限公司	2024.12.15	国际先进
21	宽带微波瓷介电容器	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.7	国内领先
22	BME 芯片电容器	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.7	国内先进
23	镍电极中高压瓷介电容器	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.7	国内领先
24	高射频功率温度补偿型电容器的设计及应用	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.7	国内领先
25	中高介电常数微波陶瓷瓷料研究及应用	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.7	国内领先
26	LTCC 低通滤波器	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.7	国内先进
27	穿心滤波器的大电流设计技术及应用	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.6	国际先进
28	高压多层瓷介电容器 - 兼容 TKD285S-4000V-273	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.6	国际先进
29	大功率金刚石薄膜负载设计技术及应用	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.6	国内领先
30	20W、30W 薄膜衰减器设计技术及应用	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.6	国际先进
31	金银混合体系电极技术的研究及应用	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.6	国际先进
32	低钎可焊端电极在多芯组上的推广应用	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.6	国际先进
33	L6 匹配电子浆料	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.5	国际先进
34	超小型（ $\phi 1.5$ 芯片）穿心滤波器研制	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.5	国际先进
35	L8 生瓷带	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.5	国际先进
36	宽带微波片式电容器	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2024.11.5	国际先进

序号	技术名称	鉴定单位	发布时间	鉴定结果
37	L8 匹配电子浆料	交铁科技评价中心 (成都)有限公司	2024.11.5	国际先进
38	金锡焊盘类芯片瓷介电容器设计技术及应用	交铁科技评价中心 (成都)有限公司	2024.11.4	国际先进
39	高压多层瓷介电容器-兼容 TKD285 系列	交铁科技评价中心 (成都)有限公司	2024.11.4	国际先进
40	脉冲功率型多层瓷介电容器	交铁科技评价中心 (成都)有限公司	2024.11.4	国内领先
41	单层片式瓷介电容器生产线宇高技术攻关	交铁科技评价中心 (成都)有限公司	2024.11.4	国内领先
42	集成电路用四边及双列扁平引线设计技术及应用	交铁科技评价中心 (成都)有限公司	2024.11.4	国际先进
43	航空用低温漂差动式直线位移传感器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
44	高精度高可靠防异物导杆式直线位移传感器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
45	宽温高精度小型角位移传感器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
46	多功能集成小型一体化惯导系统电磁兼容组件	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先
47	航空防/除冰探测系统高性能滤波组件	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
48	小型化接触式换向有刷电机尖峰电磁干扰抑制 滤波器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内先进
49	飞机副主动力系统一体化电磁兼容部件	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先
50	高可靠宽频螺装式抗射频干扰滤波器技术	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
51	高可靠发动机点火装置用低通滤波器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先
52	高效成型精密弯式阵列滤波器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先
53	耐腐蚀密封快速插拔水下特种连接器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
54	大功率脉冲电源系统用高储能密度猝发脉冲电 容器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
55	空间电磁推进用超高压脉冲电容器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
56	基于过渡金属连接的高可靠玻封二极管 PTC 热 敏电阻器技术及应用	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国际先进
57	基于大功率激光熔焊的高可靠大电流采样电阻 器技术及应用	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先
58	高精度高稳定性表贴式负温度系数热敏电阻器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先
59	可适应综合应力环境的超小型长寿命点火电容 器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先
60	航空航天用耐超大电流的高散热交流组合式电 容器	中科合创(北京)科技 成果评价中心	2023.12.21	国内领先

序号	技术名称	鉴定单位	发布时间	鉴定结果
61	超小型 X2 类抑制电磁干扰用高温金属化膜电容器	中科合创（北京）科技成果评价中心	2023.12.21	国内领先
62	多芯组瓷介电容器	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2023.10.10	国内领先
63	针对小型精密零件的双带料加工技术	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2023.05.06	国际先进
64	自动化高精度多层贴膜装置及方法	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2023.05.06	国内领先
65	留边型单层芯片瓷介电容器	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2022.07.16	国内领先
66	芯片电容用介质陶瓷材料	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2022.07.16	国内领先
67	3C 精密零组件不锈钢镦压成型技术	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2022.05.13	国际先进
68	3C 精密支架类屏蔽零组件产品及其制备技术	交铁科技评价中心（成都）有限公司	2022.05.13	国内领先

#### （四）主要经营和财务数据及指标

根据发行人申报会计师信永中和出具的 XYZH/2025BJAG1B0430 号标准无保留意见的《审计报告》，发行人报告期各期主要财务数据如下：

项目	2025.6.30 /2025 年 1-6 月	2024.12.31 /2024 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
资产总额（万元）	572,007.12	539,892.45	509,313.89	465,214.50
归属于母公司所有者权益（万元）	276,530.43	258,245.05	241,287.59	210,358.73
资产负债率（母公司）	65.33%	63.97%	63.75%	56.87%
资产负债率（合并）	34.66%	35.59%	36.46%	39.90%
营业收入（万元）	152,801.93	249,382.90	272,656.92	314,608.57
净利润（万元）	36,968.07	38,589.82	59,799.32	69,009.63
归属于母公司所有者的净利润（万元）	25,676.78	26,824.29	41,167.11	47,551.72
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	24,863.79	25,191.14	38,798.46	46,842.91
基本每股收益（元）	2.82	2.94	4.52	5.22
稀释每股收益（元）	2.82	2.94	4.52	5.22
加权平均净资产收益率	9.52%	10.74%	18.23%	24.94%
经营性活动产生的现金流量净额（万元）	19,294.06	55,308.55	74,064.96	28,004.63
现金分红（万元）	-	7,292.96	10,027.82	10,691.47
研发投入占营业收入的比例	5.97%	8.35%	9.42%	9.37%



## （五）发行人存在的主要风险

### 1、与发行人相关的风险

#### （1）财务风险

##### ①毛利率波动的风险

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月，发行人综合毛利率分别为 50.28%、53.49%、43.56%和 50.59%。其中，电子元器件业务毛利率分别为 67.91%、65.83%、54.90%和 58.52%，精密零组件业务毛利率分别 23.26%、22.67%、19.69%和 25.16%。

受下游防务领域客户加强成本管控等因素影响，报告期内发行人电子元器件产品销售价格整体呈下降趋势，导致 2023 年和 2024 年电子元器件业务毛利率有所下滑。从政策层面来看，下游防务领域低成本可持续发展战略目前尚未发生根本性改变，若未来下游客户进一步加强成本管控，公司高可靠产品仍面临着降价的可能，而公司若未能通过产品结构优化、成本控制及技术升级等方式有效应对，则毛利率面临进一步下滑的风险。

报告期内，公司精密零组件业务毛利率相对稳定。但随着苹果产业链的产能外移，国内订单减少，市场竞争加剧可能导致价格竞争。此外，下游消费电子市场竞争较为激烈，如未来苹果公司产品的优势地位下降或出货量显著下滑，有可能导致苹果公司压缩采购成本，进而导致产业链上供应商的利润水平下降。

在申报会计师出具的《盈利预测审核报告》基础上，公司测算了主要产品单价较预测报告不同程度上升或下降对 2025 年业绩的影响程度，具体如下：

单位：万元

单价及毛利率变动程度	2025 年营业收入	同比	2025 年净利润	同比
<b>（1）高可靠电子元器件</b>				
单价较预测报告上升 10%，对应毛利率上升 3.61%（绝对值）	282,156.47	13.14%	62,877.57	62.94%
单价、毛利率与预测报告相同	264,198.12	5.94%	46,900.99	21.54%
单价较预测报告下降 10%，对应毛利率下降 4.41%（绝对值）	246,239.77	-1.26%	30,924.41	-19.86%
<b>（2）精密零组件</b>				
单价较预测报告上升 10%，对应毛利率上升 6.84%（绝对值）	269,969.93	8.26%	52,035.86	34.84%

单价及毛利率变动程度	2025 年营业收入	同比	2025 年净利润	同比
单价、毛利率与预测报告相同	264,198.12	5.94%	46,900.99	21.54%
单价较预测报告下降 10%，对应毛利率下降 8.36%（绝对值）	258,426.31	3.63%	41,766.12	8.23%

注：假设产品单位成本和销量不发生变化，仅分析单价变动带动毛利率变动时，对 2025 年全年业绩的影响；分析单个主要产品单价波动时，默认其他主要产品单价不发生变化。

## ②应收账款及应收票据规模较大和坏账损失的风险

2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末，公司应收账款和应收票据账面价值分别为 186,608.35 万元、184,589.44 万元、191,530.92 万元和 226,058.38 万元，占流动资产的比重分别为 54.25%、49.60%、50.88%和 55.91%，占比较高。公司电子元器件产品主要面向航空航天、武器装备等防务领域客户，近两年来，受下游防务领域装备型号调整、项目延迟等因素影响，防务类客户的内部资金拨付流程和外部的付款审批流程普遍延长，客户的销售回款周期拉长，导致公司的整体应收账款及应收票据合计余额、账龄 1 年以上的应收账款及应收票据余额和占比均呈增加态势。

报告期各期末，公司的应收账款及应收票据余额分别为 199,965.42 万元、197,907.02 万元、207,023.11 万元和 244,603.53 万元，其中 1 年以上的应收账款及应收票据余额分别为 21,523.45 万元、21,739.97 万元、38,183.98 万元和 53,786.80 万元，占各期末余额的比例分别为 10.76%、10.98%、18.44%和 21.99%，1 年以上的应收账款及应收票据余额和占比呈增长态势，其中 2025 年 6 月末的应收账款及应收票据余额、1 年以上的应收账款及应收票据余额及占比增长显著，主要是由于公司下游防务类客户的回款集中在各年度的第四季度所致。

报告期内，受下游防务类客户回款周期放缓导致应收账款及应收票据整体余额和长账龄余额增加，应收账款及应收票据的坏账准备计提金额增加。报告期各期末，公司的应收账款及应收票据计提的坏账准备金额分别为 13,357.06 万元、13,317.58 万元、15,492.19 万元和 18,545.15 万元，占各期末应收账款及应收票据余额的比例分别为 6.68%、6.73%、7.48%和 7.58%，应收账款及应收票据的坏账准备计提金额和计提比例逐年增加。

虽然防务领域客户整体信用良好，货款最终无法收回的风险较小，但若未来国家财政支出或国防政策发生变化，导致公司主要客户回款能力下降甚至货款无

法收回，将对公司生产经营产生不利影响。

### ③存货规模较大及跌价损失的风险

2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 102,338.78 万元、105,249.57 万元、95,771.38 万元和 89,854.99 万元，占流动资产比重分别为 29.75%、28.28%、25.44%和 22.22%，占比较高。报告期各期末，公司的存货余额以高可靠产品的存货余额为主，基于防务领域的特殊性，公司的防务类客户订单整体呈小批量、多批次的特点，相当部分的订单产品订购量较小，达不到公司设备单批次生产的最小投料量或最小经济生产批量，虽然公司已按照多项次整合和集约化生产的方式排产，但由于部分防务类客户的订货数量相对零散，在最小生产批量的影响下，仍然会产生一定数量的完工存货无对应在手订单支撑的情况，导致长库龄存货增加；同时，报告期初，下游电子元器件市场需求旺盛，为满足防务领域的供货及时性要求，公司进行了适度的前瞻性备货，后续受下游防务领域装备型号调整、项目延迟等因素影响，公司的存货销售结转不及预期，导致长库龄存货增加。报告期各期末，公司 1 年以上的存货余额分别为 31,130.64 万元、46,842.77 万元、50,522.46 万元和 47,043.58 万元，占各期末存货余额的比例分别为 25.71%、35.62%、41.54%和 39.69%，1 年以上的存货余额及占比整体呈增长态势。

报告期各期末，公司的存货跌价准备计提金额分别为 18,757.36 万元、26,253.39 万元、25,862.42 万元和 28,658.92 万元，各期末的存货跌价计提比例分别为 15.49%、19.96%、21.26%和 24.18%，存货跌价准备金额和计提比例逐年上升，主要是由于公司 1 年以上的存货余额及占比增加所致。

公司已根据企业会计准则要求进行存货跌价准备计提和执行存货跌价测试，并采取“以销定产”和“储备式生产”相结合的生产备货模式，若未来下游客户需求出现重大变化，公司将面临存货跌价准备增加的风险，进而对经营业绩产生不利影响。

### ④实际结算金额低于暂估收入的风险

报告期内，发行人存在暂估收入的情况，2022 年至 2025 年 1-6 月，暂估收入金额分别为 0、4,876.82 万元、3,735.55 万元和 5,047.35 万元，占营业收入的

比例分别为 0、1.79%、1.50%和 3.30%，暂估收入的产生主要是由于下游防务领域客户接受军品审价导致。发行人作为防务领域基础元器件配套供应商，其产品通常不会直接接受军品审价，但可能作为重要配套产品，在下游客户军品审价时接受延伸审价，导致报告期内存在少量产品的销售以暂定价格确定收入的情况。自 2023 年以来，由于受到国际战争形态变化等因素影响，各防务领域集团公司在装备建设中积极推进低成本可持续发展战略。受装备建设思路变化影响，公司部分防务领域客户出于管控成本的要求，其在向公司采购产品时会先签订暂定价条款，以确保后续如果涉及军品审价，相关降价风险能够向上游转移。因此，公司未来可能面临按照暂定价确认的收入金额增长的情况。

截至报告期末，2024 年度的暂估收入已实际结算 31.86 万元，实际结算金额与暂估收入金额不存在差异，报告期内其他暂估收入暂未结算。若后续下游防务领域客户完成军品审价后，与公司的实际结算金额低于暂估收入金额，差额部分将导致收入调减，进而对公司经营业绩造成不利影响。

发行人模拟测算了报告期内暂估收入金额在不同结算比例和价格调整幅度情况下对未来业绩的影响程度，具体如下：

单位：万元

不同结算比例和结算金额	2026 年营业收入	同比	2026 年净利润	同比
<b>1.报告期内暂估收入中 10%在 2026 年结算</b>				
实际结算金额与暂估收入金额一致	264,198.12	0.00%	46,900.99	0.00%
实际结算金额较暂估收入金额下降 20%	263,925.56	-0.10%	46,658.51	-0.52%
实际结算金额较暂估收入金额下降 50%	263,516.73	-0.26%	46,219.60	-1.45%
<b>2.报告期内暂估收入中 30%在 2026 年结算</b>				
实际结算金额与暂估收入金额一致	264,198.12	0.00%	46,900.99	0.00%
实际结算金额较暂估收入金额下降 20%	263,380.45	-0.31%	46,083.32	-1.74%
实际结算金额较暂估收入金额下降 50%	262,153.94	-0.77%	44,856.81	-4.36%
<b>3.报告期内暂估收入中 50%在 2026 年结算</b>				
实际结算金额与暂估收入金额一致	264,198.12	0.00%	46,900.99	0.00%
实际结算金额较暂估收入金额下降 20%	262,835.33	-0.52%	45,538.20	-2.91%
实际结算金额较暂估收入金额下降 50%	260,791.16	-1.29%	43,494.03	-7.26%

注：假设 2026 年的经营业绩数据与 2025 年盈利预测保持一致。

## ⑤汇兑损益风险

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月，发行人汇兑损益分别为 -2,196.22 万元、-337.37 万元、-632.76 万元和 -103.74 万元，汇兑损益占当期归母净利润的比重分别为 -4.62%、-0.82%、-2.36% 和 -0.40%，呈现一定波动。报告期内，发行人产生汇兑损益主要系精密零组件外销通常以美元和欧元结算，汇兑损益金额受到结汇规模、结汇时点、汇率变动等多种因素影响。若未来汇率出现大幅波动，公司将面临因汇率变动导致汇兑损失的风险。

## （2）经营风险

### ①经营业绩下滑的风险

2022 年至 2025 年 1-6 月，公司营业收入分别为 314,608.57 万元、272,656.92 万元、249,382.90 万元和 152,801.93 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 47,551.72 万元、41,167.11 万元、26,824.29 万元和 25,676.78 万元。2023 年度，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别下降 13.33% 和 13.43%；2024 年度，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别下降 8.54% 和 34.84%；2025 年 1-6 月，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别同比增长 2.63% 和下降 4.80%。

### A. 电子元器件业务

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月，公司电子元器件业务销售收入分别为 188,118.61 万元、193,339.13 万元、175,251.51 万元和 117,480.31 万元。2023 年和 2024 年，电子元器件业务销售收入分别同比增长 2.78% 和下降 9.36%；2025 年 1-6 月，电子元器件业务销售收入同比增长 5.97%。

报告期内，发行人电子元器件产品以高可靠产品为主，主要应用于防务领域，高可靠产品占电子元器件销售收入的平均比例为 89.41%。高可靠产品中又以陶瓷电容器为主，报告期内陶瓷电容器占高可靠产品销售收入的平均比例为 63.20%。发行人经营业绩主要受高可靠产品收入变动的的影响。2024 年，由于受到下游客户加强成本管控等外部环境因素的影响，发行人高可靠产品销售价格下降，导致经营业绩有所下降。2022 年至 2025 年 1-6 月，公司高可靠电容器平均销售价格分别为 10.18 元/件、8.80 元/件、7.35 元/件和 7.40 元/件，整体呈下降趋

势，2023 年至 2025 年 1-6 月变动比例分别为-13.56%、-16.53%和 0.76%。

自 2023 年以来，由于受到国际战争形态变化等因素影响，各防务领域集团在装备建设中积极推进低成本可持续发展战略。如果未来上述低成本可持续发展战略未发生转变，高可靠产品销售单价因行业政策、客户采购策略或市场竞争等因素出现超预期下滑，而公司未能通过产品结构优化、成本控制及技术升级等方式有效应对，则电子元器件业务可能面临业绩下滑的风险。

### **B.精密零组件业务**

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月，公司精密零组件业务销售收入分别为 114,203.90 万元、62,369.14 万元、55,283.96 万元和 29,246.98 万元。2023 年和 2024 年，精密零组件业务销售收入分别同比下降 45.39%和 11.36%；2025 年 1-6 月，精密零组件业务销售收入同比增长 4.73%。

报告期内，发行人精密零组件业务经营业绩整体呈下降趋势，主要原因系：①2023 年，受下游消费电子市场需求放缓的影响，终端客户苹果公司的产品需求下滑；②受终端客户苹果公司产业链外移影响，发行人下游客户在越南、泰国、印度、巴西等地扩建工厂，中国大陆的部分产能被转移，而公司未及时配合进行海外建厂，导致部分订单被其他能够配合海外建厂的竞争对手所分流。苹果产业链外移进程预计需要较长时间，发行人仍将在苹果产业链中占据一定市场份额，但经营业绩预计将持续受到影响。

如果未来消费电子市场需求增长持续放缓，发行人新能源电池及汽车结构件业务、非苹果产业链消费电子业务拓展不达预期，以及受苹果产业链外移影响发行人现有订单份额持续被竞争对手分流，公司精密零组件业务经营业绩将面临进一步下滑的风险。

### **②市场竞争加剧的风险**

公司电子元器件产品以防务领域客户及相关科研院所为主，行业的资质门槛及技术壁垒较高。但在国家鼓励军工电子产业发展的背景下，如有实力强劲的新竞争对手涉入公司业务领域，且在技术研发、产品质量、客户服务等方面形成相对优势，则公司将面临市场竞争加剧的风险。

### **③客户相对集中的风险**

2022年、2023年、2024年和2025年1-6月，公司对前五大客户销售收入总额分别为200,857.00万元、181,171.81万元、150,181.37万元和97,316.96万元，占营业收入的比重分别为63.84%、66.45%、60.22%和63.69%，公司客户集中度相对较高。如果未来公司与下游市场主要客户合作出现不利变化、新客户拓展计划不如预期，或公司主要客户因行业竞争加剧、宏观经济波动、终端需求变化等原因引起市场份额下降，则可能导致主要下游客户减少对公司产品的采购量，从而给公司经营带来不利影响。

#### **④进出口政策变化风险**

报告期内，公司精密零组件产品以外销为主，电子元器件产品部分原材料需要从境外采购。近年来部分国家和地区在国际贸易战略和进出口政策等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，多次宣布对中国商品加征进口关税。目前上述政策尚未对公司出口业务产生重大不利影响，但如果未来贸易摩擦升级，相关国家对公司的出口产品加征高额关税等，可能对公司的外销业务产生不利影响。

为应对部分国家的关税保护主义，我国政府可能适时提高对相关国家的进口关税，进而提升发行人进口原材料采购成本。未来若因国际贸易摩擦或进出口政策进一步调整导致部分原料采购价格上升或采购受限，将会对公司的业务产生不利影响。

#### **⑤产品质量控制风险**

电子元器件产品为公司利润的主要来源，其主要应用于航空航天、武器装备等防务领域，上述领域客户对产品的可靠性、一致性及稳定性通常有特殊要求。若公司质量控制流程出现瑕疵导致产品质量出现问题，尤其在具有重大国内影响项目的应用中出现质量问题，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还将对公司品牌及后续供货资格造成重大不利影响。

#### **⑥部分房产无法办理产权证书以及部分经营性租赁房产存在瑕疵的风险**

公司及子公司部分房产及构筑物因相关手续缺失等原因导致无法办理产权证书，上述无证房产及构筑物主要为生产辅助用房，占比较低，存在被认定为违章建筑从而导致被主管部门行政处罚的风险。此外，公司部分经营性租赁房产存

在未办理产权证书以及租赁房产未按规定向房产管理部门办理登记备案的情况。上述租赁房产存在被当地主管部门要求拆除或拆迁，导致发行人被要求搬迁或遭受当地主管部门处罚或其他损失，从而对发行人的经营和财务状况产生不利影响的风险。

### **(3) 管理风险**

#### **①业务规模迅速扩大引致的经营管理风险**

本次发行后，公司业务、资产及人员规模将进一步扩大，公司需在产品研发、资源整合、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进一步提升管理能力。若未来公司管理能力的提升滞后于业务规模的扩大，不能继续保持较高的管理效率，将对公司市场竞争、组织管理等方面产生不利影响。

#### **②专业人员流失风险**

公司所处行业属于技术密集型行业，产品品控、新品研发和客户服务高度依赖公司的技术实力、工艺水平和员工经验，对相关技术人员、销售人员的综合素质要求较高。随着公司现有业务的不断拓展和募投项目的投入，若未来公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，将对公司长远发展产生不利影响。

#### **③实际控制人控制风险**

本次发行前，四川能源发展集团通过川投信产直接控制发行人的股权比例达到 56.50%，预计本次发行后控制公司约 42.38%的股份，仍处于控制地位。若四川能源发展集团、川投信产利用其对公司的控制地位，通过行使表决权及管理职能对公司的人事、经营管理和财务管理等予以不当控制，可能会对公司和其他股东的利益造成不利影响。

#### **④老宿舍区等物业管理风险**

宏明电子前身为国营七一五厂，老宿舍区位于成华区建设路 71 号一街坊和建设路 43 号四街坊，至今仍有多栋上世纪 50、60 年代自建自管的职工宿舍楼。在 2008 年“5.12”汶川特大地震发生后，上述宿舍楼被第三方鉴定机构按照当时的房屋鉴定规则鉴定为 D 级整幢危房。出于安全考虑，发行人在震后决定立



即对危房住户实施撤离过渡应急处置工作，并通过停收租金和物业费、支付搬离补偿金、实施产权置换或货币补偿终结住房关系等方式动员危房住户搬离，但截至报告期末，仍有部分住户基于个人经济条件或权益诉求不愿意搬离。加之没有整体搬迁的国家或地方政策，公司无法强制住户搬离危房。考虑到上述房屋与国营七一五厂老宿舍区的历史渊源，为保障居住人员与财产安全，公司每年投入大量人力物力，包括但不限于无偿为该等住户提供日常物业服务，采取房屋加固措施，加强日常巡逻、维护等。该等危房在 2016 年再次鉴定中已经排除整幢危房状态，可以基本正常使用。但若发生不可抗力风险，仍会给公司带来一定管理风险。

此外，公司历史上为解决部分困难职工住房问题，以自有土地修建了经济适用房（宏明锦苑小区）出售给符合条件的内部职工。截至目前，公司正在按照政府有关部门要求分批次办理产权分户手续。由于宏明锦苑修建时间较长，加上期间成都市经济适用房政策变化大，导致目前办理分户产权时，部分认购人因各种原因可能存在资格瑕疵，从而导致发行人可能面临一定的诉讼风险。

#### ⑤潜在债务纠纷风险

因历史遗留原因，自 2010 年开始，本公司失去对控股子公司上海宏明的控制权，未掌握上海宏明的实际经营情况，上海宏明的经营管理权由少数股东实际控制。报告期内，为了妥善解决上述遗留问题，重新掌握上海宏明的经营情况，公司采取了沟通协商、改选董事会及管理层、起诉少数股东等多种方式。截至 2025 年 2 月，上海宏明通过诉讼方式取得少数股东返还的上海宏明营业执照、银行印鉴等重要资料，并重新控制上海宏明。

经核查，上海宏明近十年处于停止运营状态，无实际经营业务。但因时间久远，少数股东尚未归还或无法归还上海宏明的财务账簿、相关业务合同（如有）等业务、财务资料，除已通过司法途径确认的本公司应收上海宏明的债权外，本公司暂不掌握上海宏明的其他债权、债务情况，有待清算时一并处理。截至目前，除本公司对上海宏明的债权外，不存在任何第三方主体向发行人主张上海宏明的有关债权或提出相关异议、纠纷。公司控股股东川投信产已出具承诺，确认：“后续如有相关方主张并能够确认对上海宏明的债权，本公司将代替上海宏明承担超出上海宏明自有资产以外的债务”。

如果未来存在相关方主张并确认对上海宏明的债权，可能会导致公司增加相关债务纠纷风险。

## 2、与行业相关的风险

### （1）技术创新风险

公司募投项目“高可靠阻容元器件关键技术研发项目”、“电子材料与元器件关键技术研发项目”等均瞄准未来3-5年行业发展前景较好的电子元器件领域，具有较强的前瞻性和引领作用。但由于产品和技术创新具有不确定性，若未来公司无法充分应对行业发展过程中出现的新形势、新要求，不能持续开发出适应市场和客户需求的产品，则公司可能面临技术创新失败的风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。

### （2）核心技术泄密风险

公司高可靠阻容元器件等产品拥有自主知识产权，主要产品的核心技术处于国内领先水平或国际先进水平，但如果公司因技术人员流失、技术资料被窃取等因素，发生核心技术失密，将对公司产品竞争力产生不利影响。

### （3）业务资质延续的风险

为防务领域客户提供产品或服务存在较为严格的资质审核制度和市场准入制度，资质申请门槛较高、程序严格，且每隔一定年限需要重新认证或许可。若未来行业准入门槛发生变化或公司在质量、保密等方面出现重大问题，导致公司丧失现有业务资质或不能及时更新相关资质，将对公司的经营产生不利影响。

## 3、其他风险

### （1）募集资金投资项目实施效果无法达到预期的风险

发行人对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性研究工作，但可行性分析是基于当前的宏观经济环境和市场条件所作。若未来项目实施过程中相关因素发生重大不利变化，如国防开支不及预期、宏观经济及市场环境发生重大变化或企业自身管理能力无法适应等，可能导致本次募集资金投资项目新增的产能无法得到有效消化，亦可能出现项目不能如期完成或不能实现预期收益等不利情形，进而影响公司的盈利能力。

## （2）豁免披露信息可能影响投资者价值判断的风险

公司主要客户为防务领域客户，部分产品生产、销售、技术和财务信息涉及国家秘密和商业秘密，不宜直接披露。根据国家和公司相关规定，公司对涉密信息采取脱密处理方式进行披露，最大限度地不影响投资者对公司基本信息、财务状况、经营成果、公司治理、行业地位、未来发展等方面的了解，对投资者决策判断不构成重大障碍，但上述部分信息豁免披露仍有可能影响投资者对公司的价值判断，造成投资决策失误。

## （3）发行失败风险

本次发行的发行结果会受到证券市场整体情况、投资者价值判断、市场供需等多方面因素的影响。本次发行过程中，若出现有效报价或认购不足等情况，则可能导致公司本次公开发行失败的风险。

## 二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数及比例	不超过 3,039 万股，不低于本次发行后公司总股本的 25%，最终发行股票的数量以中国证监会同意注册的数量为准。
发行人高管、员工拟参与战略配售情况	发行人高管、员工将在发行前确认是否参与本次发行战略配售，具体按照深圳证券交易所相关规定执行。
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人及申银万国创新证券投资有限公司（为实际控制保荐人的证券公司依法设立的子公司）将在发行前确认是否参与本次发行战略配售，具体按照深圳证券交易所相关规定执行。
发行价格	【】元/股
发行市盈率	【】倍（每股收益按照【】年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加新股发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市场交易账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会、深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理

承销方式	余额包销
发行费用概算	
(1) 承销费用	【】万元
(2) 保荐费用	【】万元
(3) 审计费用	【】万元
(4) 律师费用	【】万元
(5) 信息披露费用	【】万元
(6) 发行手续费及其他费用	【】万元
合计	【】万元

### 三、本次证券发行项目组情况

#### (一) 本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源承销保荐作为成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为龙家立和黄学圣。

保荐代表人龙家立的保荐业务执业情况：管理学硕士，2016 年起从事投资银行业务，曾参与了华丰科技（688629）科创板 IPO、长虹能源（836239）北交所上市、大元泵业（603757）主板 IPO、沈阳来金汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目等 IPO 项目。除宏明电子外，目前无以签字保荐代表人身份签署已申报在审企业。

保荐代表人黄学圣的保荐业务执业情况：经济学硕士，注册会计师，2000 年开始从事投资银行业务，曾担任华丰科技（688629）科创板 IPO、南侨食品（605339）主板 IPO、八方股份（603489）主板 IPO、元祖股份（603886）主板 IPO、至正股份（603991）主板 IPO、久其软件（002279）中小板 IPO、华星创业（300025）创业板 IPO、上工申贝（600843）主板非公开发行、长虹能源（836239）北交所上市项目等的保荐代表人。除宏明电子外，目前担任在审企业重庆至信实业股份有限公司首次公开发行并在上海证券交易所主板上市项目的签字保荐代表人。

#### (二) 本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

##### 1、项目协办人

本次证券发行项目协办人为徐健。

项目协办人徐健的保荐业务执业情况：国际经济与贸易硕士，2016 年起从事投资银行业务，曾参与沈阳来金汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650121040007 号执业证书，执业记录良好。

## 2、项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：秦明正、罗弘历、陈恭告、刘雨彤、冉启航、翟浩景、朱灵刚、刘希、刘子铭、杨雅菲、徐晴。

秦明正：经济学硕士，2006 年起从事投资银行业务，曾负责或参与了建峰化工（000950）、重庆实业（000736）、海信科龙（000921）、中船防务（600685）等重大资产重组项目，ST 华立（600097）、ST 国药（600641）、ST 二纺机（600604）、ST 得亨（600699）等并购重组项目，元祖食品（603886）、至正股份（603991）、翔丰华（300890）等 IPO 项目以及上工申贝（600843）、美菱电器（000521）等非公开发行股票项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650716050037 号执业证书，执业记录良好。

罗弘历：应用经济学硕士，2020 年开始从事投资银行业务，曾参与华丰科技（688629）科创板 IPO、长虹能源（836239）北交所上市等项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650120070004 号执业证书，执业记录良好。

陈恭告：法律硕士，中国注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格证书，2022 年开始从事投资银行业务，持有中国证券业协会颁发的 S1650122080014 号执业证书，执业记录良好。

刘雨彤：应用经济学硕士，2022 年开始从事投资银行业务，曾参与华丰科技（688629）科创板 IPO、中科美菱（835892）北交所上市等项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650122030039 号执业证书，执业记录良好。

冉启航：金融数学硕士，2021 年开始从事投资银行业务，曾参与沈阳来金汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市、八方股份（603489）非公开发行股票等项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650121050011 号执业证书，执业记录良好。

翟浩景：管理学硕士，2024 年开始从事投资银行业务，持有中国证券业协

会颁发的 S1650124080007 号执业证书，执业记录良好。

朱灵刚：经济学硕士，2024 年开始从事投资银行业务，持有中国证券业协会颁发的 S1650124080006 号执业证书，执业记录良好。

刘希：金融学硕士，2023 年开始从事投资银行业务，曾参与安集科技（688019）公开发行可转债、美联股份（873980）北交所上市辅导等项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650123050004 号执业证书，执业记录良好。

刘子铭：医学硕士，2023 年起从事投资银行业务，持有中国证券业协会颁发的 S1650123080011 号执业证书，执业记录良好。

杨雅菲：金融学硕士，持有法律职业资格证书，2013 年开始从事投资银行业务，先后参与力盛赛车（002858）、诚邦园林（603316）、南侨食品（605339）等 IPO 项目，智慧农业（000816）等再融资项目，持有中国证券业协会颁发的 S1650116040068 号执业证书，执业记录良好。

徐晴：理学硕士，2024 年开始从事投资银行业务，曾参与重庆至信实业股份有限公司首次公开发行并在上海证券交易所主板上市项目。持有中国证券业协会颁发的 S1650124040002 号执业证书，执业记录良好。

#### **四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说明**

经核查，截至本上市保荐书签署日，发行人与保荐人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

1、申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）为本保荐人的间接控股股东，申万宏源全资子公司宏源汇富创业投资有限公司持有四川川投信产申万宏源股权投资管理有限公司 51%股权；发行人控股股东川投信产持有四川川投信产申万宏源股权投资管理有限公司 49%股权。上述情形不会对本保荐人及保荐代表人的独立性和公正履行保荐职责产生不利影响。

除上述情况外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方亦不存在持

有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

3、本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

4、本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

## **五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项**

（一）本保荐人承诺，已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。保荐人同意推荐成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

（二）本保荐人承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所对推荐证券上市的相关规定，自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

## **六、保荐人按照有关规定应当说明的事项**

### **（一）发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序**

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序，具体如下：

（一）发行人于 2025 年 4 月 15 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》以及《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》等议案，并将上述议案提交股东大会审议。

（二）2025 年 5 月 7 日，发行人召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》《关于修订〈成都宏明电子股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》《关于公司上市后三年分红回

报规划的议案》。

## （二）发行人符合创业板定位及国家产业政策所作出的专业判断的说明

经核查，保荐人认为发行人符合创业板定位及国家产业政策，具体如下：

### 1、公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合

发行人作为国内老牌电子元器件生产企业，始终坚持创新驱动发展战略，推动公司基础材料、基础研究、新产品、新工艺和新门类产品的研发与生产，持续推动创新成果与产业的深度融合。在电子元器件领域，公司实现新产品研发、技术升级、结构创新、工艺优化、产品迭代、智能化生产，促进科技成果高水平应用和生产要素创新性配置，曾创造了国内第一条有机薄膜介质电容器国军标生产线、第一条宇航级 MLCC 生产线、第一条正温度系数热敏电阻器国军标生产线、第一条负温度系数热敏电阻器国军标生产线、第一条抗电磁干扰滤波器国军标生产线等多项国内第一，拥有多条国军标生产线及宇航级高可靠生产线。

发行人前身是国营第七一五厂，创建于 1958 年。自创建以来，发行人不断学习、引进前苏联、欧美、日本等国家的先进技术，通过自主创新掌握多项具有自主知识产权的核心技术，不断拓宽新产品门类，推动产品技术迭代升级和产业转型升级，全力推进国家电子元器件及电子功能材料的自主创新和自主可控，汇集优势资源实现阻容元件、滤波器、微波器件等核心产品的国产化替代，培育国家单项冠军产品，并不断向电子功能材料、组件两端延伸产业链，同时依托模具技术和核心制造能力培育精密零组件新赛道核心竞争力，以满足下游客户对新技术、新产品的应用需求，对于下游整机装备的发展以及产品的更新迭代起到了重要支持作用，促进产业转型升级、新动能发展壮大。

发行人先后承担了数百项国家重点工程配套元器件及电子功能材料研发项目，承担和参与 61 项国家（军用）标准、行业标准制修订，取得各类科研成果数百项。产品广泛应用于国家各类重点项目中。通过不断创新，有力地推动了行业的发展，并实现了新技术、新业态、新模式与传统产业的深度融合，有效促进了新质生产力的进步。



## 2、发行人技术创新性

在陶瓷电容器产品领域，为解决制约国产 MLCC 发展的陶瓷粉体、电极材料的制造工艺瓶颈，公司依托国家“863”电子瓷料研发中心和电极浆料研发中心，已突破相关配方设计技术、掺杂改性技术、纳米粉体分散技术、粉体制备技术等，开发出高介、高频、高压、高温、高储能、高 Q 值等不同系列三十余种陶瓷介质材料，满足了 MLCC 的生产需求。其中，脉冲储能电容器瓷料及制备的产品技术填补了国内空白，并开发出与之匹配的内外电极浆料十余种，包括钼银内电极、纯银端电极、钼银端电极等，实现国外同类材料的国产化替代。

同时，为满足 MLCC 高比容高绝缘电阻、低介电损耗的发展需求。公司攻克了介质薄层化制备技术，提升了薄膜表面平整度，加强了粉体颗粒排布；攻克了高精度电极印刷技术，印刷电极厚度精度可达到 $\pm 0.04\mu\text{m}$ ；攻克了高精度叠层技术，可在超薄介质膜片上实现多层精密堆叠；攻克了高精度切割技术和快速烧结技术，批产的高比容产品在国内率先通过了高可靠应用验证，最高容量达到 $220\mu\text{F}$ 。2021 年，发行人特种多层陶瓷电容器产品被工信部、中国工业经济联合会评为“制造业单项冠军产品”。

在高度集成化的芯片电容器热点研究领域，公司突破了微型产品及异型产品设计技术、瓷料及基片制备技术、陶瓷基片成型技术、薄膜电极成型技术、精密切割成型技术以及装配封装和检测技术；可实现 $0.254\text{mm}\times 0.254\text{mm}$ 及以上尺寸的产品批产，电压覆盖 16V-160V，实现国外同类产品的国产化替代。

在有机及云母电容器产品领域，公司建立了国内首条高可靠产品生产线，攻克了超薄型介质薄膜卷绕、云母纸真空浸渍、高可靠灌封等关键技术，公司研制的表贴式有机薄膜电容器、高压云母纸电容器率先通过了防务领域客户认定试验，实现了对国外同类产品的国产化替代，满足了重点项目对高可靠产品的迫切需求，科技成果多次被评价为国际先进。

在位移传感器产品领域，公司打破了技术封锁，攻克了电阻浆料制备技术和磁路设计技术，形成 3 个方阻系列浆料配方，建立了国内最高寿命的导电塑料电位器国军标生产线，公司导电塑料位移传感器产品寿命达到 1,000 万周，精度达到 0.2%，实现了同类国外产品的国产化替代，为多项国家重点项目提供了技术

支持，科技成果多次被评价为国际先进。

在热敏电阻器产品领域，公司拥有 PTC、NTC 热敏电阻两条国军标线以及国内唯一的两条热敏电阻器高可靠生产线，攻克了热敏电阻器瓷料设计技术，拥有从  $22\Omega\sim 100M\Omega$  系列化热敏电阻器陶瓷瓷料配方，满足航空、航天及电子等领域对高精度测温、控温及温度补偿的需求，为多项国家重点项目提供了技术支持，科技成果多次被评价为国际先进。

在滤波/连接器产品领域，公司建立了国内第一条 EMI 滤波器国军标生产线，拥有从滤波组件生产、连接器零件生产到滤波连接器组装、电磁兼容解决方案全产业链研制生产能力，产品安装直径仅为 2mm，电容量达到 5,000pF，为多项国家重点项目提供了技术支持，科技成果多次被评价为国际先进。

### 3、发行人属于现代产业体系

宏明电子主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售，致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品。同时，公司还涉及精密零组件业务，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域和新能源电池及汽车电子结构件等领域。公司所处行业属于国家鼓励和支持的战略新兴产业，系现代产业体系的重要组成部分。

历经六十余年积淀与发展，发行人现已形成集研发中心、孵化基地、国家认证实验室为一体的研发体系。公司拥有 1 个国家“863”电子瓷料研发中心、1 个国家企业技术中心、1 个国家认证检测校准实验中心、1 个国家认证检测实验中心、6 个省级工程（技术）研究中心、3 个省级企业技术中心、2 个院士（专家）工作站、1 个技能大师工作室，是国家高新技术企业、**国家专精特新小巨人企业**、国务院科改示范行动标杆企业。

发行人具备进一步研发、深度利用相关技术及模式的能力，且该能力具备可持续性，发行人的产品、服务均体现了发行人在电子元器件、精密零组件产品领域的深度积累和应用，属于发行人的核心产品及服务，发行人具备较强的创新能力，发行人属于现代产业体系。

### 4、发行人的成长性

2022 年至 2025 年 1-6 月，公司营业收入分别为 314,608.57 万元、272,656.92

万元、249,382.90 万元和 152,801.93 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 47,551.72 万元、41,167.11 万元、26,824.29 万元和 25,676.78 万元。报告期内，公司经营业绩呈现下降趋势主要系受到下游防务领域客户装备型号调整、项目延迟及加强成本管控等因素影响，以及终端消费电子市场需求相对低迷、精密零组件业务终端客户供应链外移影响。

随着我国国防事业的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，公司核心产品高可靠电子元器件作为基础元件的需求将持续增长。同时，近年来我国国防投入稳步增加，2025 年国防支出预算 17,846.65 亿元，同比增长 7.2%，保持近年来较高增长。国防建设重点从机械化向信息化的强势转化，进一步带动了军工电子行业和相关基础元器件的配套需求，预计“十五五”期间国防预算支出仍将有较大的增长空间。

公司坚持以技术创新为驱动，构建了完备的研发体系和保持技术不断创新的体制，创新能力能够支撑其成长。宏明电子作为国内少数从高品质电子材料（陶瓷瓷料和导电浆料）到电子元器件均具备研制能力的全产业链生产企业，自主掌握核心技术，未来发展前景广阔。公司未来成长性可持续。

5、发行人符合创业板行业领域

报告期内，发行人主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售，同时涉及精密零组件领域，致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品和精密零组件产品。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业或禁止类行业。

6、发行人符合创业板定位相关指标

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条规定，公司符合创业板定位相关指标二的要求，具体如下：

指标内容	是否符合	主要依据
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于	是	2022-2024 年，公司研发费用合计为 75,972.65 万元，超过 5,000

25%。		万元，符合标准。
最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。	是	2024 年度，公司营业收入为 24.94 亿元，超过 3 亿元，可不适用营业收入复合增长率相关要求。

（三）发行人符合《上市规则》规定的上市条件的说明

保荐人依据《上市规则》相关规定，对发行人是否符合《上市规则》2.1.1 规定的上市条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

- 1、发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件；
- 2、符合发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元；

发行人本次发行前股本总额为9,116.2018 万元，本次拟公开发行不超过 3,039 万股，发行后总股本不超过 12,154.9358 万元，不低于人民币 3,000 万元。

- 3、符合公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；

发行人本次发行前股本总额为9,116.2018 万元，本次拟公开发行不超过 3,039 万股，公开发行的股份不低于发行后股份总数的 25%。

- 4、市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准；

发行人最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，符合《上市规则》2.1.2 第一项规定的上市标准。

- 5、符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上，保荐人认为，发行人符合《上市规则》规定的上市条件。

七、保荐人对发行人持续督导工作的安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在股票上市当年剩余时间以及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况

事项	安排
2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人按照《公司章程》《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务情况、股权变动情况、管理层重大变化情况、采购和销售变化情况、核心技术变化情况以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，对发行人进行定期及不定期现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
（二）发行人应当积极配合保荐人履行持续督导职责	发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权，为保荐工作提供必要的条件和便利

## 八、其他说明事项

无。

## 九、保荐人结论

申万宏源承销保荐认为，成都宏明电子股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。申万宏源承销保荐愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人：

徐健

徐健

保荐代表人：

龙家立

龙家立

黄学圣

黄学圣

内核负责人：

孙艳萍

孙艳萍

保荐业务负责人、法定代表人：

王明希

王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015 年 12 月 13 日

